

# 株主の皆さまへ

## 第46期報告書

2023年4月1日から2024年3月31日まで



### トップメッセージ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

ここに、当社第46期報告書（2023年4月1日から2024年3月31日まで）をお届けし、事業の概況等についてご報告申し上げます。

当連結会計年度における世界経済は、欧米などでのインフレ抑制に向けた金融引き締め継続や長引く中国不動産市場の低迷により回復ペースが鈍化しました。また、ロシア・ウクライナ危機や中東情勢などの地政学的リスクを背景に先行き不透明な状況が続きました。

半導体業界につきましては、世界的にPCやスマートフォンなどの民生品需要が低調に推移し、メモリ半導体を中心に在庫調整が続いたことから、関連設備の投資抑制も続きました。一方で、生成AIの普及に向けて、超広帯域メモリ（HBM：High Bandwidth Memory）などサーバー向け投資の需要は急速に拡大しています。また、各国政府による半導体産業への支援は後工程にも波及しており、日本や北米などでも後工程の設備投資が期待されます。

このような状況のもと、当社グループは生成AI関連向けに当社独自のコンプレッション装置「CPM1080」の需要が大きく拡大したことから、当連結会計年度のコンプレッション装置、金型の受注高及び売上高は通期で過去最高となりました。

今後とも、株主の皆さまのご期待にお応えいたすべく、グループ一丸となって邁進していく所存でございますので、何卒一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

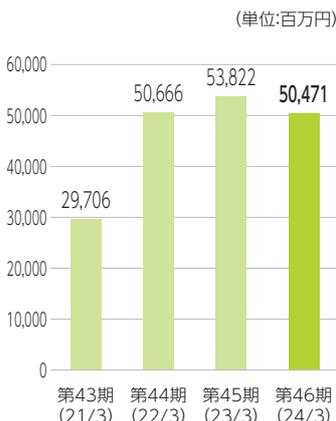
2024年6月



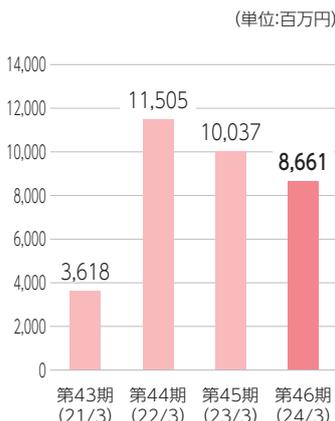
代表取締役社長  
**岡田博和**

### 業績ハイライト

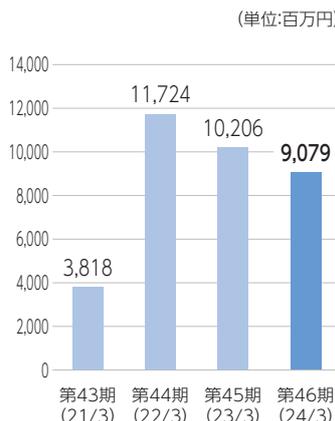
#### 売上高



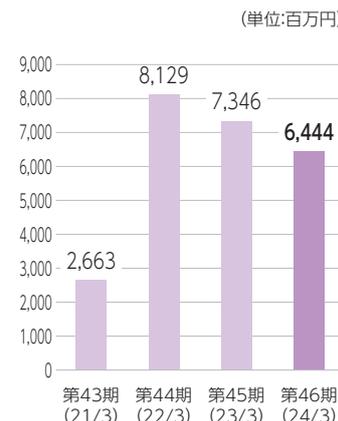
#### 営業利益



#### 経常利益



#### 親会社株主に帰属する当期純利益



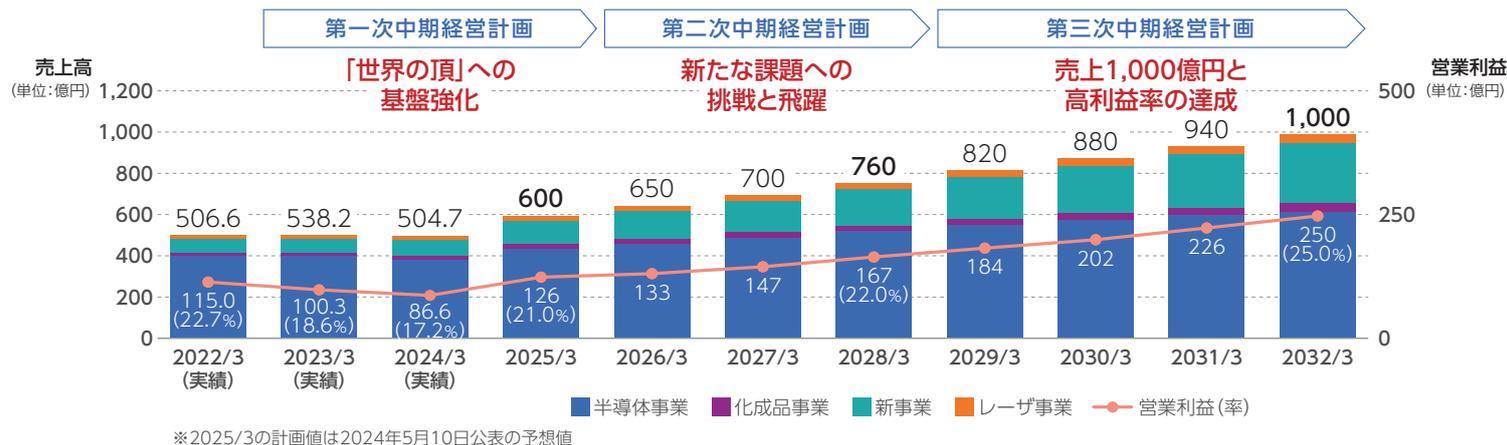
## 第46期の概況と今後の計画

PCやスマートフォンなど民生品向けの売上が低調であったことから、売上高は前期比で減収となりました。利益につきましては、売上高の減少により、各段階利益ともに前期比で減益となったものの、コンプレッション装置の売上比率の増加にともない、製品ミックスが改善したことから当初予想は上回りました。

通期では減収減益となったものの、第4四半期（2024年1月～3月期）は生成AI関連向けのコンプレッション装置の納入が本格化したことなどから、売上高が大きく拡大し、四半期連結売上高は184億38百万円、同営業利益は45億86百万円となり、四半期で売上高、各段階利益ともに過去最高となりました。

## TOWAビジョン2032の概要

テーマ：変革で世界の頂へ



## 第一次中期経営計画（2023年3月期～2025年3月期）の概要

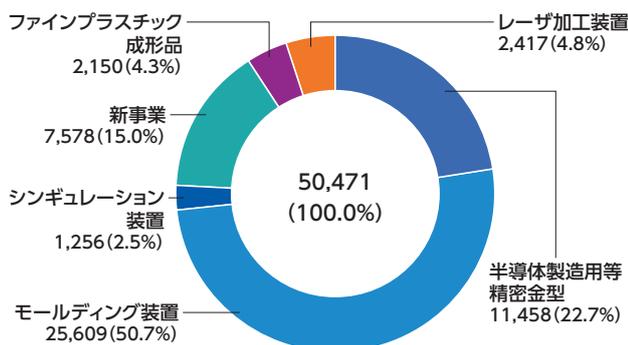
テーマ：TOWAが創り出すプロセスイノベーション

	2023年3月期		2024年3月期			2025年3月期
	計画	実績	当初計画	2023/5/11公表	実績	計画
売上高	550	538.2	570	510.0	504.7	600
半導体事業	420	412.7	425	370.6	383.2	443
化成事業	19	19.5	20	20.0	21.5	22
新事業	86	80.1	100	93.4	75.8	104
レーザ事業	25	25.9	25	26.0	24.2	31
営業利益	122	100.3	124	81.6	86.6	126
営業利益率	22.2%	18.6%	21.8%	16.0%	17.2%	21.0%
経常利益	122	102.0	124	81.6	90.7	126
当期純利益(※)	85	73.4	87	57.1	64.4	88

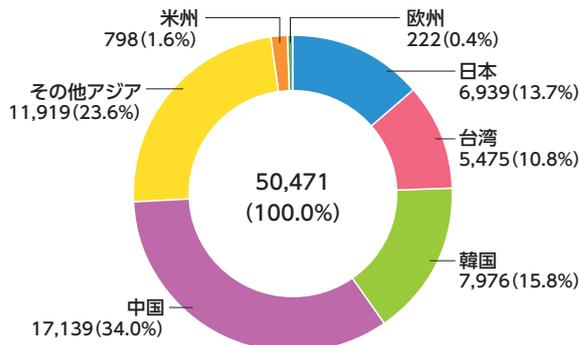
※ 当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

## セグメント別連結売上高（第46期）

■製品別（単位：百万円）



■地域別（単位：百万円）



## 競争力の源泉 ▶ コンプレッション装置・金型の受注・売上高ともに過去最高

半導体の樹脂封止技術には、大きく分けてトランスファとコンプレッションの2つの方式があります。当社は、世に先駆けてマルチプランジャでの全自動半導体樹脂封止装置を開発し、業界標準を確立して以来、半導体モールドング市場において、リーディングカンパニーであり続けています。長年の実績を誇るトランスファ方式に加え、当社独自のコンプレッション方式で、市場のニーズを先取りしたモールドプロセスをご提案しています。

生成AIや自動車の自動運転、データセンターの拡張に伴う半導体の需要増加が進んでいる中で、タブレットやスマートフォンなどのデバイスも多様化しています。

半導体のパッケージング技術においては、より薄型で高密度な設計が求められ、ウェハレベルでのパッケージングや高い生産性とコスト削減を可能にする成形プロセスが必要とされています。当社は市場の要求に迅速に応えるため、コンプレッション方式による革新的な成形技術を保有しております。

パッケージの薄型化が進む中で、大型のパネルやウェハに対しても均一で薄い樹脂の供給が必要です。当社はキャビティダウン方式を採用しており、大型のモールド面積に対しても均一で極薄のモールドを実現しています。

キャビティアップ方式に比べ、成形時の反りが少なく、その優位性が認められており、2024年3月期においては、生成AI関連向け投資などの増加により、当社独自のコンプレッション装置・金型の受注・売上高ともに過去最高となりました。

### 独自のキャビティダウン構造

- 独自のキャビティダウン方式により、素早く、高い真空度を実現し、高精度の狭ギャップ成形を実現！



### コンプレッション技術の活用が期待される分野

- 生成AI
- 次世代AIスマホ
- 自動運転
- ウェハレベルパッケージ
- パネルレベルパッケージ
- 2.5D、3Dパッケージ

## 事業の拡大 ▶ 韓国で新たに工場を取得

韓国地域における生成AIの普及が進む中、高性能半導体の需要が高まっています。これに応じて、先端半導体向けの設備投資が顕著に拡大しており、将来にわたり各半導体メーカーによる積極的な投資が続くと予想されています。

この動向を受け、韓国での半導体製造装置の生産能力の増強と納期の短縮を目的として、新たに工場資産を取得いたしました。既存の建物を有効活用することで、早期の生産ライン立ち上げが可能となり、市場の要求に迅速に応じる体制を整えることができます。加えて、半導体製造装置の生産だけに留まらず、装置のリニューアルビジネスやラボ機能の拡充を図る予定です。これにより、技術革新の迅速な対応や新たなビジネスチャンスの創出にも寄与することが期待されます。

今回の固定資産の取得は、TOWA韓国株式会社にとって重要なマイルストーンであり、同社の生産能力を現在の2倍にまで引き上げることが可能になり、市場競争力の強化に直結するものと考えています。



## リレーションの強化 ▶ 展示会での最新技術PR

### TOWA Technology Exhibition開催



2023年12月から2024年1月までにかけて、本社工場にて「TOWA Technology Exhibition 2023」を開催いたしました。

先端パッケージ向けや省人化などテーマに沿った当社の製品や技術を紹介し、国内外から多くのお客様にご来場いただきました。

### SEMICON JAPAN 2023出展



2023年12月13日から15日までの3日間、東京ビッグサイトにて開催されたSEMICON JAPANに出展いたしました。

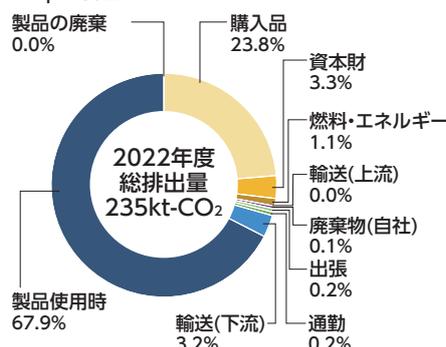
今後の技術革新の核となる生成AI向け半導体や、トレンドの車載半導体など多様なパッケージの成形技術の提案や、世界各地のお客様へのサポート体制の紹介を行いました。

## サステナビリティ ▶ Scope3に関する取り組み

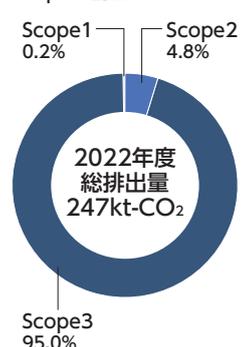
当社グループは、これまで自社で直接使用する電気や燃料に関するCO<sub>2</sub>排出量に対して削減目標を設定し、カーボンニュートラルを目指して取り組んでまいりました(Scope1,2の取り組み)。

昨年度は、自社の活動に関連するサプライチェーン全体での間接排出へも取り組みを広げるために、それらに関わる排出量の算定を進めました(Scope3の取り組み)。排出量の多い製品使用時のCO<sub>2</sub>排出削減を中心に取り組みを推進し、サステナブルな社会実現への貢献を図っていきます。

### Scope3排出量



### Scopeの割合



## 会社の概要 (2024年3月31日現在)

商号 TOWA株式会社  
(英文名TOWA CORPORATION)  
設立 1979年4月17日  
資本金 8,955,671,632円  
本社所在地 京都市南区上鳥羽上調子町5番地  
☎ (075) 692-0250 (代表)  
従業員数 623名(単体) 1,985名(連結)  
上場取引所 東京証券取引所プライム市場

## 役員 (2024年6月27日現在)

代表取締役社長	岡田博和
取締役常務執行役員	石田耕一
取締役上席執行役員	柴原信隆
取締役執行役員	西村一洋
取締役執行役員	三浦宗男
取締役常勤監査等委員	服部広志
社外取締役監査等委員	和氣大輔
社外取締役監査等委員	後藤美穂
社外取締役監査等委員	田中素子
上席執行役員	早坂昇
上席執行役員	鈕方舜
上席執行役員	韓相倫
執行役員	笹田秀典
執行役員	中西和彦
執行役員	寺内利浩※

※2024年7月1日付就任予定

## 株主メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年

定時株主総会 毎年6月

基準日 株主総会権利行使及び期末配当 3月31日  
中間配当 9月30日

単元株式数 100株

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号  
みずほ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号  
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

郵便物の郵送先及び  
電話お問い合わせ先 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号  
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 ☎0120-288-324 (フリーダイヤル)

株主総会資料の電子提供  
制度(書面交付請求)に  
ついてのお問い合わせ先 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部  
☎0120-524-324 (電子提供制度専用フリーダイヤル)

未払い配当金のお支払 みずほ信託銀行 本店及び全国各支店  
みずほ銀行 本店及び全国各支店

公告方法 電子公告の方法により行います。但し、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。

公告掲載URL <https://www.towajapan.co.jp>

## 株式の状況 (2024年3月31日現在)

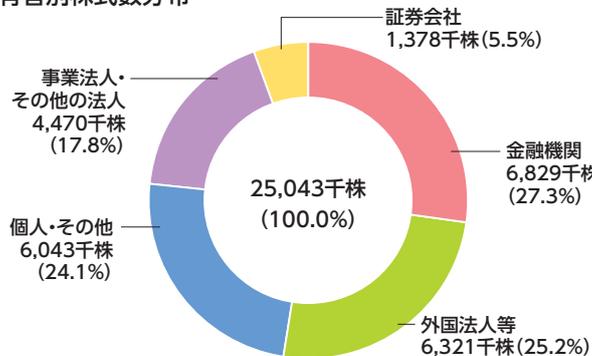
●発行可能株式総数 80,000,000株  
●発行済株式の総数 25,043,888株  
●株主数 19,871名  
●大株主

株主名	持株数	持株比率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	3,139(千株)	12.54(%)
株式会社日本カストディ銀行	2,417	9.66
株式会社ケイビー恒産	1,900	7.59
株式会社エヌレガロ	1,260	5.03
MORGAN STANLEY & CO. LLC	1,060	4.24
株式会社京都銀行	699	2.80
GOLDMAN,SACHS & CO.REG	419	1.67
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT	374	1.50
TOWA社員持株会	341	1.37
JPモルガン証券株式会社	257	1.03

(注1) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行の持株数は信託業務に係るものです。

(注2) 持株比率は、自己株式(14,179株)を控除して計算しております。

### 所有者別株式数分布



TOWA株式会社

<https://www.towajapan.co.jp>

